



利機企業股份有限公司

股票代號：3444

2023 *Investor Meeting*

# 法人說明會

發言人 Claire Lu 盧修滿  
2023.03.10

發言人：盧修滿協理 / [claire@niching.com.tw](mailto:claire@niching.com.tw)  
代理發言人：邱智芳協理 / [chris@niching.com.tw](mailto:chris@niching.com.tw)  
股務聯絡人：陳玲芝課長 / [cherry@niching.com.tw](mailto:cherry@niching.com.tw)



# 投資安全聲明

本內容可能包含「前瞻性陳述」，包括(但不限於)未來展望、預測及估算等預期性之陳述。這些前瞻性陳述乃基於本公司經營的信念及對於未來的目前看法。這些看法可能受到內外在風險及不確定性因素影響，有造成實際結果與陳述內容顯著不符之可能。

本文件所做出的任何前瞻性陳述僅於陳述日當日適用，投資者應有自主判斷，不應過分依賴該等前瞻性陳述。對於這些看法，除法規規定外，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。本節所述的警告聲明適用於本簡報所載的所有前瞻性陳述。



# 公司簡介

- 創立：1993年
- 資本額：3.9億 (增資後4.4億)
- 上櫃時間：2008年
- 營業據點：

台中



新竹



高雄



蘇州



- 營業項目：



## 通路代理

半導體、FPD、LED相關材料、零件與設備



## 自有研發與製造

先進奈米科技材料：

1. 觸控銀漿、低溫燒結銀膠等相關材料
2. 奈米孔洞材料NPM ( Nano Porous Material )



# 營運報告

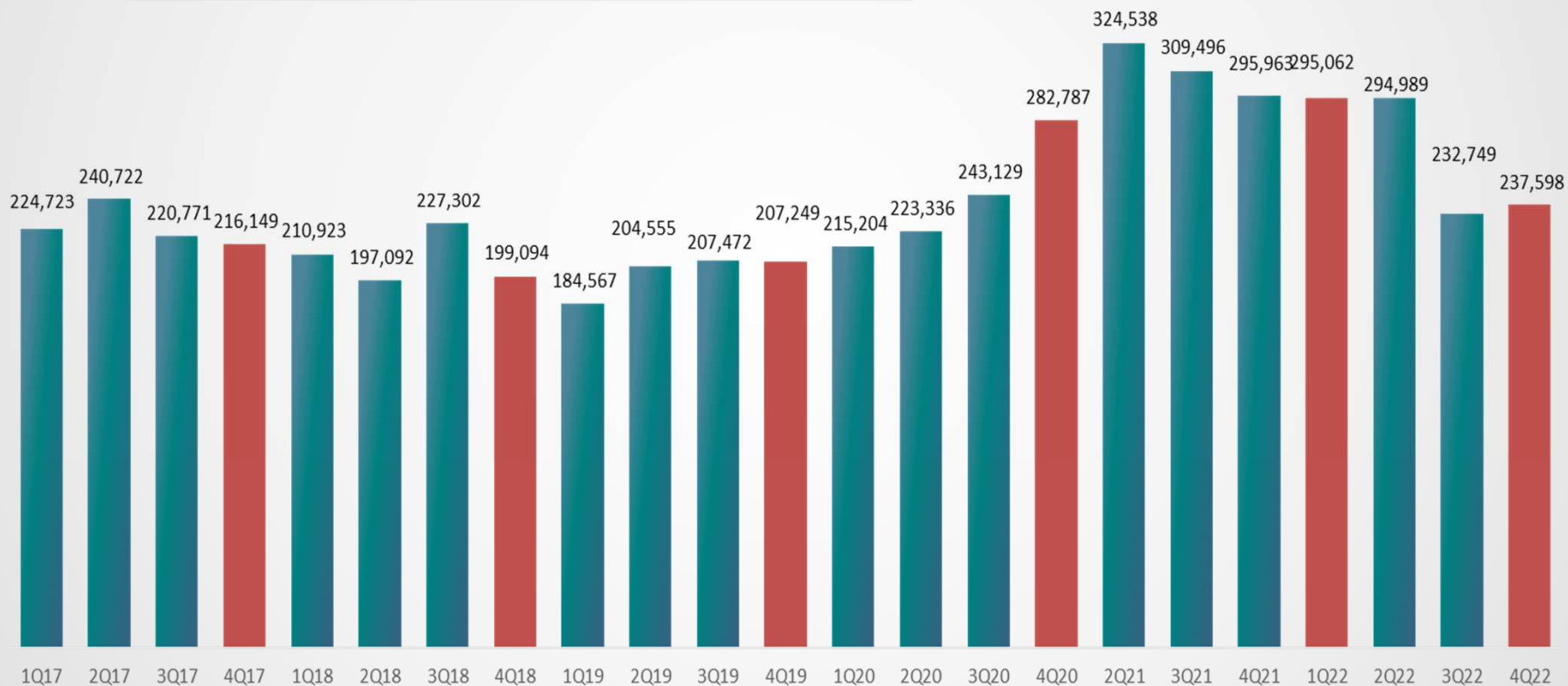
2022Q4



# 季別營收

單位：仟元

年度	2017	2018	2019	2020	2021	2022
營業收入	902,365	834,411	803,842	964,457	1,218,919	1,060,398

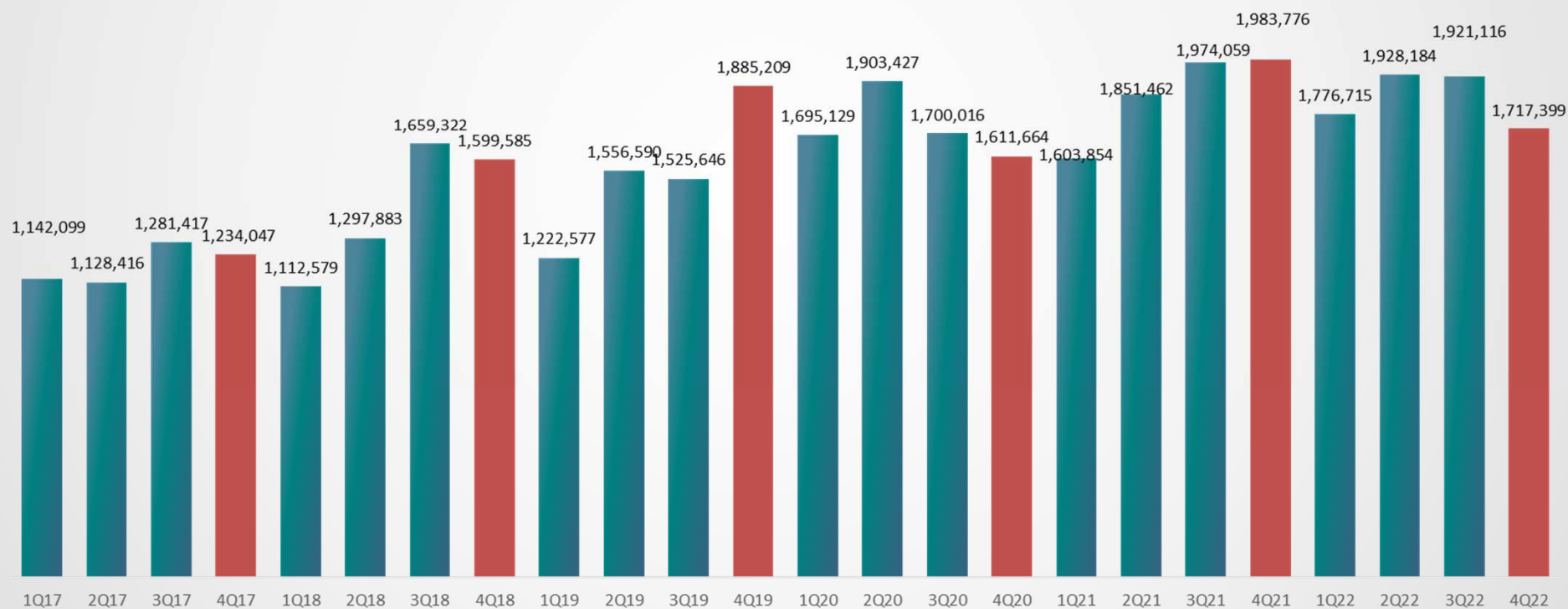




# 季別整體交易金額

單位：仟元

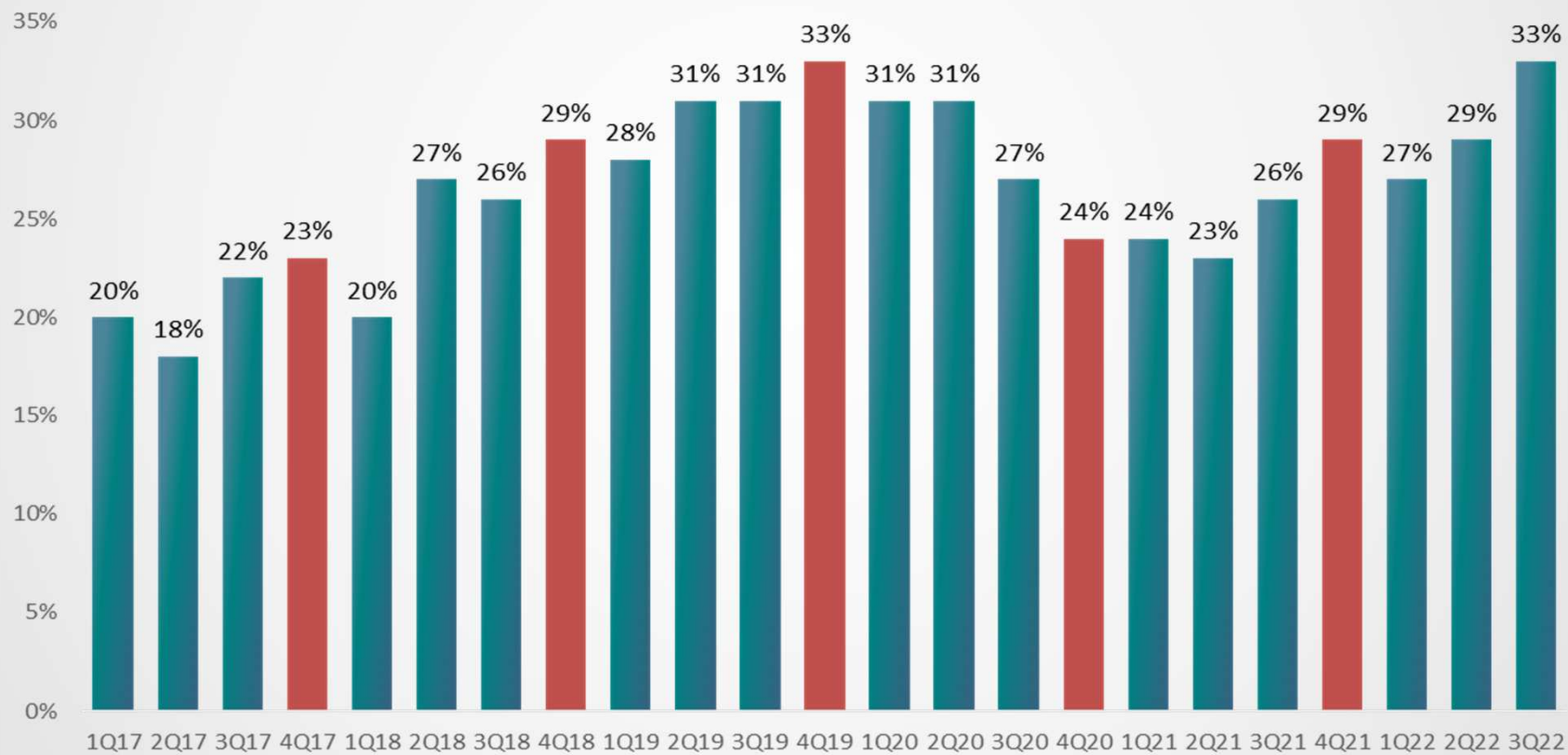
年度	2017	2018	2019	2020	2021	2022
接單金額	4,785,978	5,669,371	6,190,021	6,910,236	7,413,152	7,343,413





# 歷年季毛利率

年度	2017	2018	2019	2020	2021	3Q 2022
毛利率	25%	25%	31%	28%	25%	29%





# 歷年季每股稅後盈餘

單位：元

年度	2017	2018	2019	2020	2021	Q3 2022
EPS	1.22	1.52	2.68	2.72	3.44	4.41

(2017~2022Q3)  
複合成長率：29.3%







# 2022每股稅後盈餘 媒體自行臆測

即時 要聞 娛樂 運動 全球 社會 地方 產經 **股市** 房市 生活 健康 橘土

udn / 股市 / 店頭未上市

## 利機 去年估賺逾半股本

2023-02-16 00:49 經濟日報 / 記者鐘惠玲 / 台北報導

+ 半等體

讚 0 分享 分享

受市況不佳影響，半導體通路商利機（3444）去年業績年減逾一成，不過，法人預期，利機去年獲利仍有機會創新高，全年有望首度賺進逾半個股本，首季應為今年谷底，後續可望逐季增長。

由於工作天數減少，加上各封裝廠持續進行庫存去化，利機1

財訊快報

18.4k 人追蹤

☆ 追蹤

## 利機前三季每股賺4.41元，估全年EPS上看5元，年增四成以上



2022年11月4日



【財訊快報 / 記者李純君報導】基板等封裝材料供應商利機企業(3444)公布，今年前三季每股淨利4.41元，而法人圈也推估，利機今年全年每股淨利上看5元，年增四成以上。

此外，該公司董事會2日也通過現金增資案，預計明年上半年發行5,000仟股普通股。利正在等候 dms-ct7k53gg8vreport.wc.yahoodns.net...

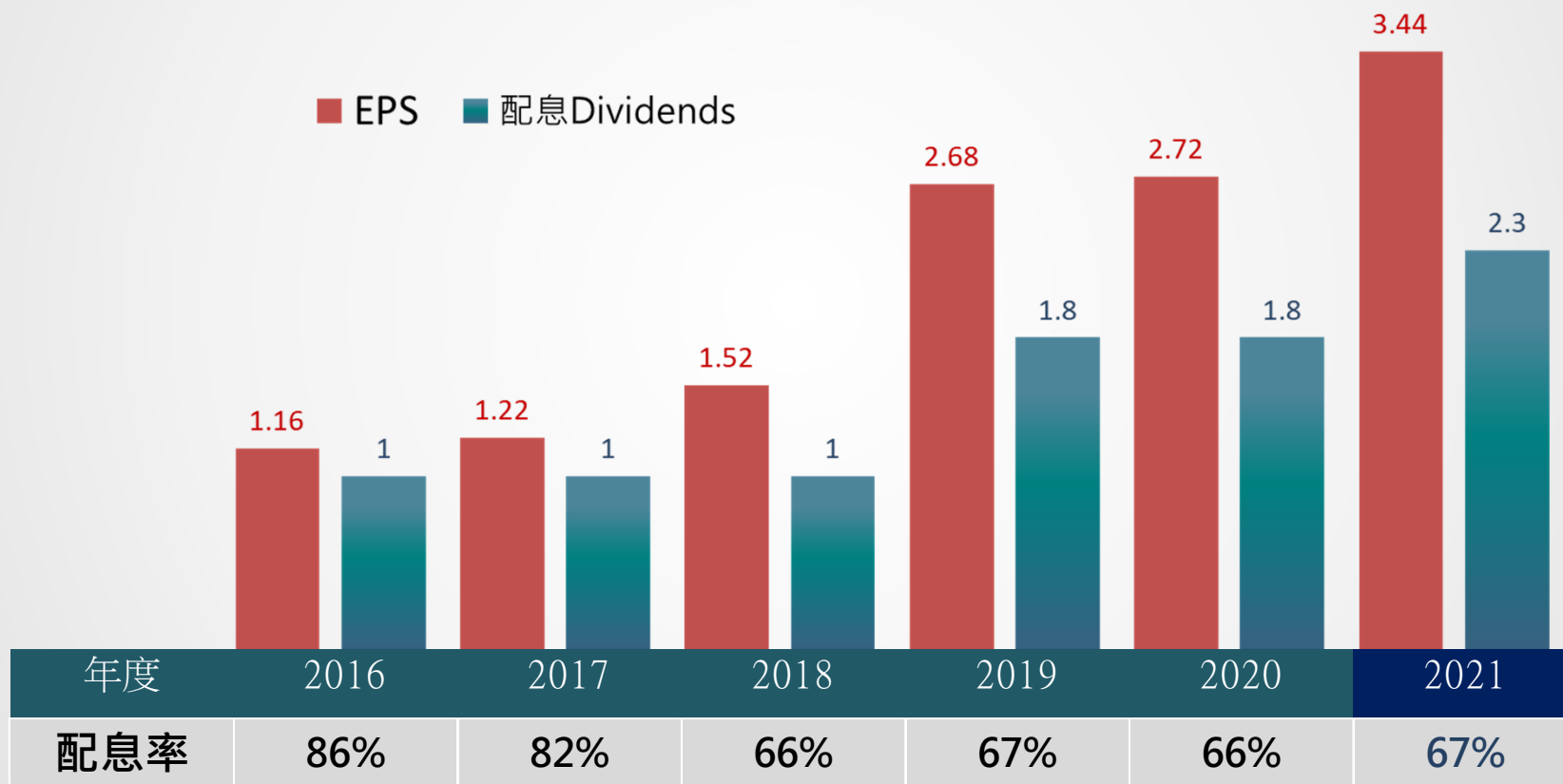


# 股東權益報酬率及稅後每股盈餘





# 歷年配息率





# 綜合損益表

2022年  
3Q 1Q~3Q 2022

(NT\$千元)	2020	2021	1Q 2022	2Q 2022	3Q 2022	1Q~3Q 2022	YoY	YoY
營業收入	964,457	1,218,919	295,062	294,989	232,749	822,800	-25%	-11%
營業毛利	269,474	310,457	78,226	85,502	75,974	239,702	-6%	6%
毛利率	28%	26%	27%	29%	33%	29%	24%	2%
營業淨利	118,685	150,568	34,268	40,316	22,815	97,399	-48%	-13%
營業外收(支)	6,510	15,294	26,453	35,414	48,037	109,904	461%	849%
稅前淨利	125,195	165,862	60,721	75,730	70,852	207,303	35%	68%
本期淨利	106,431	134,428	50,822	61,955	59,531	172,308	38%	75%
淨利率	11%	11%	17%	21%	26%	21%		
EPS (NT\$)	2.72	3.44	1.31	1.58	1.52	4.41	38%	75%



# 資產負債表

NT\$仟元	2017	2018	2019	2020	2021	3Q 2022
<b>資產</b>						
現金及約當現金	146,231	137,517	181,508	170,088	279,765	328,496
應收帳款	296,894	326,653	308,359	597,702	509,553	459,030
存貨	73,509	52,375	42,020	47,736	66,764	66,858
轉投資相關	60,741	115,827	179,631	188,357	205,830	250,136
不動產、廠房及設備	232,336	230,989	228,328	227,025	228,528	228,529
其他資產	49,786	48,740	198,747	71,074	23,817	21,584
<b>資產總計</b>	<b>859,497</b>	<b>912,101</b>	<b>1,138,593</b>	<b>1,301,982</b>	<b>1,314,257</b>	<b>1,354,633</b>
<b>負債</b>						
短期借款	20,000	15,000	173,000	224,782	126,429	150,000
應付帳款	193,419	158,465	159,823	240,718	265,051	182,810
其他負債	65,621	88,201	110,332	99,569	115,613	120,637
<b>負債總計</b>	<b>279,040</b>	<b>261,666</b>	<b>443,155</b>	<b>565,069</b>	<b>507,093</b>	<b>453,447</b>
<b>權益總計</b>	<b>580,457</b>	<b>650,435</b>	<b>695,438</b>	<b>736,913</b>	<b>807,164</b>	<b>901,186</b>
<b>淨值 (NT\$元)</b>	<b>14.84</b>	<b>16.63</b>	<b>17.78</b>	<b>18.84</b>	<b>20.64</b>	<b>23.04</b>



# 營 運 展 望

2023 Q1 & Q2



# 營運三佈局

**獲利擴張**  
企業價值提升



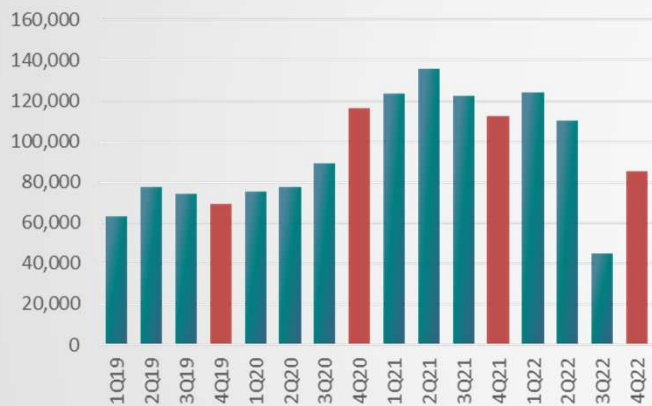
**獲利新機**  
發展未來機會

**獲利根基**  
鞏固核心業務



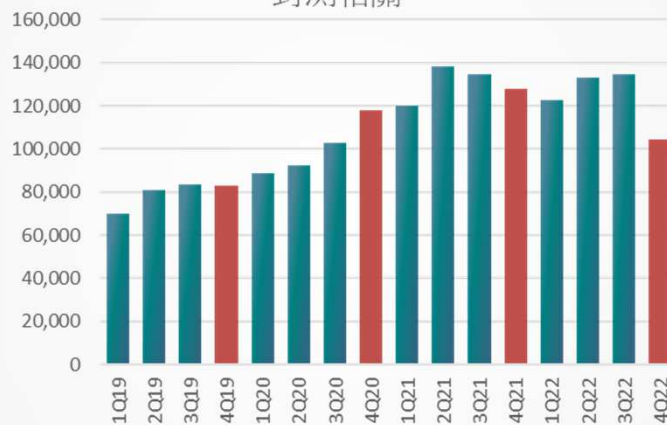
# 營運佈局一：通路代理 景氣終有回來時

### 驅動IC相關



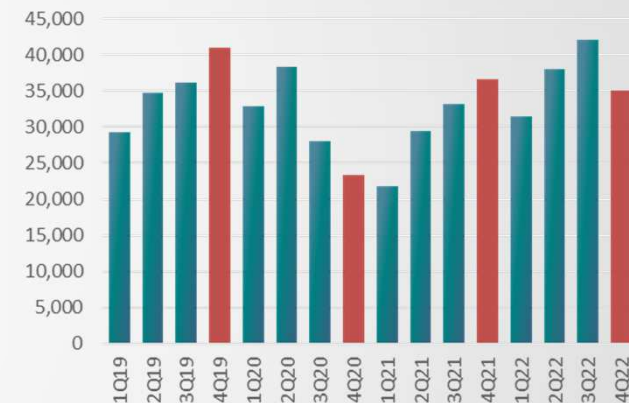
- 1. 2022Q4營收回穩
- 2. 部份急單&工控、車用支撐需求

### 封測相關



- 1. 市況不佳，預計Q1~Q2落底
- 2. 客戶仍進行擴產，對長期仍樂觀
- 3. 均熱片持續成長

### 記憶體/邏輯IC載板

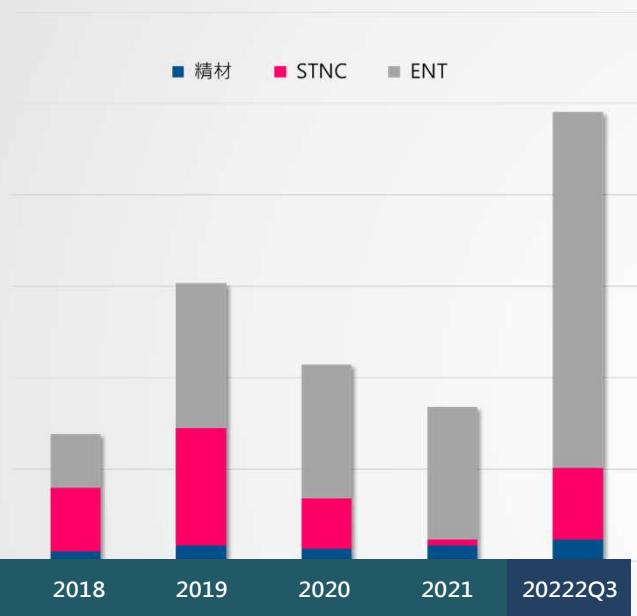


- 1. 調整產品組合持續提升邏輯載板佔比





# 營運佈局二： 加值型轉投資 創歷史新高



(NT\$仟元)	2018	2019	2020	2021	2022Q3
精材	1,008	1,680	1,344	1,680	2,351
STNC	6,982	12,799	5,493	669	7,806
ENT	5,901	15,904	14,669	14,485	38,928
TOT	13,891	30,382	21,506	16,834	49,085

## ENT 利騰國際

- 中系與美系客戶需求增加
- 先進製程相關轉以成熟製程產品取代，反而在短期內可能增加新開案需求

## STNC 信泰蘇州

- 與半導體載板景氣同步，預計下半年景氣回升

## 精材科技

- 與驅動IC市場景氣同步，Q1已有明顯回升



# 營運佈局三：自有產品 自有產品核心技術 & 能力

獨特自有技術，材料

跨入高頻、高電壓的半導體元件材料，例如第三類半導體、MOSFET等

擴展銀漿產品的應用範圍和提升性能，跨入高導熱之固晶及介面散熱材料(TIM)

更廣泛應用於微型電子元件、柔性電子元件、嵌入式系統、生物醫學器械等領域。



觸控銀漿

自製奈米銀粉

低溫燒結銀漿

銀粉燒結固化技術

高導熱銀漿

有機材料改質與特性調控

客製化銀漿

異質材料界面快速導電膠合技術

- ✓ 應用範圍廣泛
- ✓ 高效、快速因應客戶需求
- ✓ 提升客戶產品效能
- ✓ 做到國外大廠無法滿足客戶的100%客製化



# 營運佈局三：自有產品 產品系列推展現狀

產品系列	EVT	DVT	PVT	MP
客製化銀漿			DX-23 (S,local) RFID	DX-30 (L,local) 車用電致變色材料
高導熱銀漿	DN-17(E,local) 車用MOSFET		DN-1715(E,local) LED車燈	DN-1705(E,local) LED車燈
低溫燒結銀漿	DN-12(A, local) IGBT	DN 1802(A, local) 封裝與測試	DN-1802(A, Netherlands) RF	
	DN-12(H, China) LED前車燈	DN-1206Q(J, China) 封裝與測試	DN-1206QL (L, local) Sensor	
		DN-1301B(S, USA) RF/PA IC		
觸控銀漿	PL-10(W, local) 消費性面板	PS-07B(S, local) 手機與汽車按鍵與模組		PL 09F(H, local) 工控面板
				PL-10(M, local) 工控面板

EVT → DVT → PVT → MP

EVT : Engineering Verification Test (工程驗證測試階段)

DVT: Design Verification Test (設計驗證測試階段)

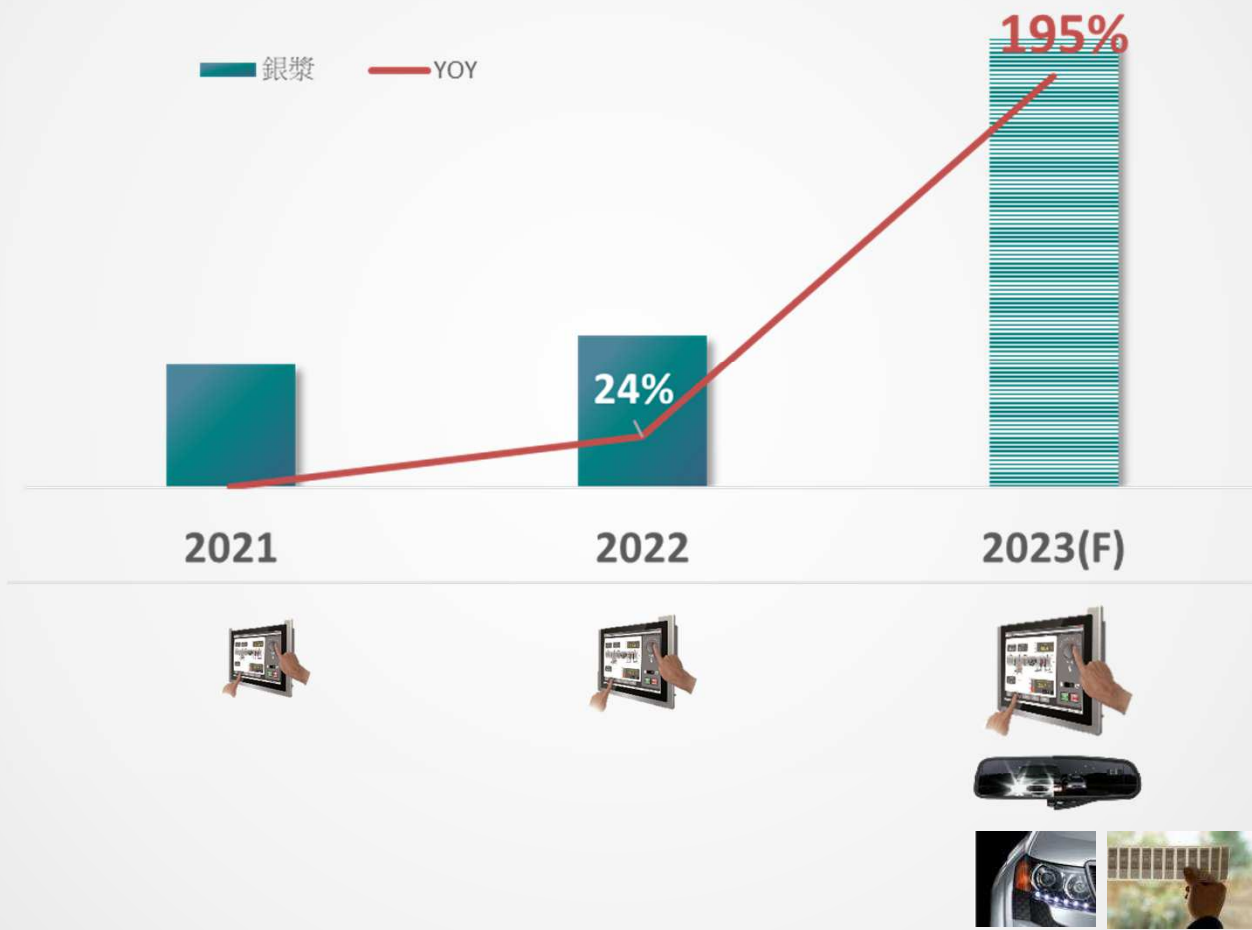
PVT: Production Verification Test (生產驗證測試階段)

MP: Mass Production (導入量產階段)



# 營運佈局三：自有產品

## 近三年自有產品營收成長率





# 本季總結

- 一. 普遍認為上半年雖然處景氣谷底，景氣終有循環，靜待下半年半導體業周期回暖。利機今年業績呈現逐月成長，緩步復甦有跡可循：
  1. 驅動IC相關：2022年最早衰退，Q1已有明顯回升
  2. 封測相關：錫針至Q1仍有庫存壓力，預計最晚Q2漸回溫。客戶端仍持續擴產，加上散熱片持續開出新規格，擴大市佔率，中期持續保有成長動能。
  3. 半導體載板：“持續看好Logic長期需求，特別在使用 Flip Chip 及先進封裝技術的客戶”，故以提高邏輯載板佔比調整產品策略。



# 本季總結

- 二. 2022年加值型轉投資之獲利貢獻創新高，2023年應仍有可觀之獲利挹注，主要來自ENT仍將維持Socket高階市場的高市佔率。
- 三. 自有產品銀漿已獲車用量產訂單，預估下半年將陸續獲得RF ID及LED車用訂單。
- 四. 2022全年獲利創新高，各投資人可參考過去配息率66%~86%。



# 近期重要事件摘要

- 一. 利機企業董事會核准辦理現金增資發行5,000仟股普通股案，已順利募資完成，增資新股於3/10掛牌。
- 二. 為因應自有產品銀漿訂單，進行擴產計畫，預計Q3可正式投產。



**THANKS**